

# H150-S 专用系列

## 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

### 应用特点：

- 高强度，超强韧性
- 高回弹性
- 高撕裂强度
- 高绝缘
- 防火性能高

### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

### 储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

### 保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

### 产品性能

NO.	参数	单位	测试方法	
颜色	粉红色	---	目视	
厚度	1~2.5	mm	ASTM D374	
硬度	35 $\pm$ 5	Shore C	ASTM D 2240	
密度	2.4 $\pm$ 0.2	g/cc	ASTM D 792	
拉伸强度	$\geq 0.35$	Mpa	ASTM D 412	
延伸率	$\geq 150$	%	ASTM D 412	
撕裂强度	$\geq 1.2$	N/mm	ASTM D 624	
压缩保持力	20%	6.86	Psi	ASTM D 695
	30%	16.28	Psi	ASTM D 695
阻燃等级	V0	---	UL-94	
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14	

### 热学特性

导热系数	1.5 $\pm$ 0.2	W/m $\cdot$ K	ASTM D 5470
热阻	$\leq 1.5$ (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

### 电学特性

击穿电压	$\geq 10$	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	$\geq 2$	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	$\leq 0.1$	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

